

パワーデバイスの現状と将来動向

～シリコンデバイスならびに新材料 パワーデバイスの特徴と課題～

筑波大学 数理物質系
岩室憲幸

1. はじめに

コロナ禍が少しづつではあるが治まりつつある状況の中、依然として解消されないのが半導体不足である。この半導体不足の理由はいくつかあるが、大きな理由の一つが CO₂排出実質ゼロを目指した自動車の電動化（xEV化）による半導体需要の急拡大とも言われている。これにより最近ではパワーデバイスの需給も逼迫しているとも伝えられており、今後はコロナ禍で落ち込んだ自動車生産の急回復を睨み、パワーデバイスは需要拡大の新たな機会が巡ってきそうな状況にある。公表された記事によるとパワーデバイス市場は今後8年間で2.6倍拡大すると見込まれている。ここに、炭化珪素(SiC)や窒化ガリウム(GaN)に代表される新材料パワーDEバイスが入り込んで需要の拡大をけん引したいところであるが、同記事によれば、新材料パワーDEバイスは2022年の約1250億円から2030年に1兆円を超える規模になるもののパワーDEバイスの大部分は2030年に至ってもシリコン(Si) DEバイスが約80%を占めると予測している¹⁾。本報では、市場の主役であり続けるSi DEバイス、特にSi IGBTの現状について解説した後、新材料パワーDEバイスとして大いに期待されているSiC/GaNパワーDEバイスの最新開発状況、ならびにこれら素子の市場拡大に向けた課題について述べる。

2. パワーDEバイスとは

2-1 その役割と要求される特性

図1は、パワーエレクトロニクス回路の中で代表的なインバータ回路の概略図とその動作を示したものである。プラグインハイブリッド自動車や電気自動車において、電池の直流電圧・電流を変換し交流モータを回すなど、車を動かす場面で使われている。まず回路内のスイッチS₁とS₄がオン、S₂とS₃がオフ状態の時、インバータ回路に接続された負荷(モータ)には上から下に電流が流れる。次の瞬間、今度はスイッチS₁とS₄がオフ、S₂とS₃がオンになると、負荷には逆に下から上向きに電流が流れる。この動作を繰り返すことにより、図に示すように入力の「直流」電圧を、負荷では「交流」電圧として取り出せることが可能となる。これがインバータ回路の動作である。つまり S₁～S₄ 半導体スイッチのオン・オフ動作によって電力を変換するのである。

パワーエレクトロニクス(以下パワエレと略す)機器は、パワーDEバイスに電流を流したり、切ったりすることで電力変換を行う。つまりパワーエレクトロニクス機器の中でパワーDEバイスは、「スイッチ」として動作するのである。このパワエレ機器の高効率化は、いかにパワーDEバイスでの損失を抑え

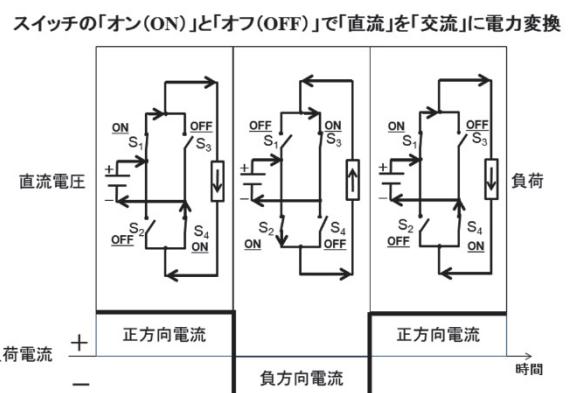


図1 インバータ回路概略図とその動作